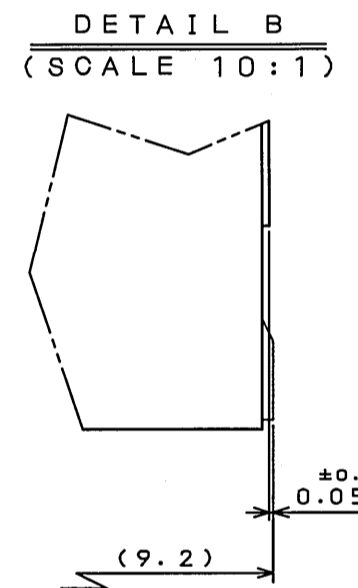
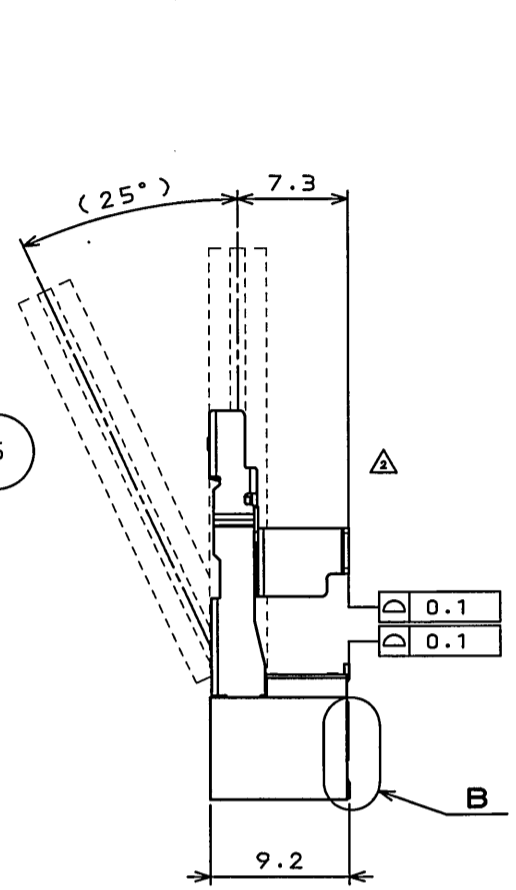
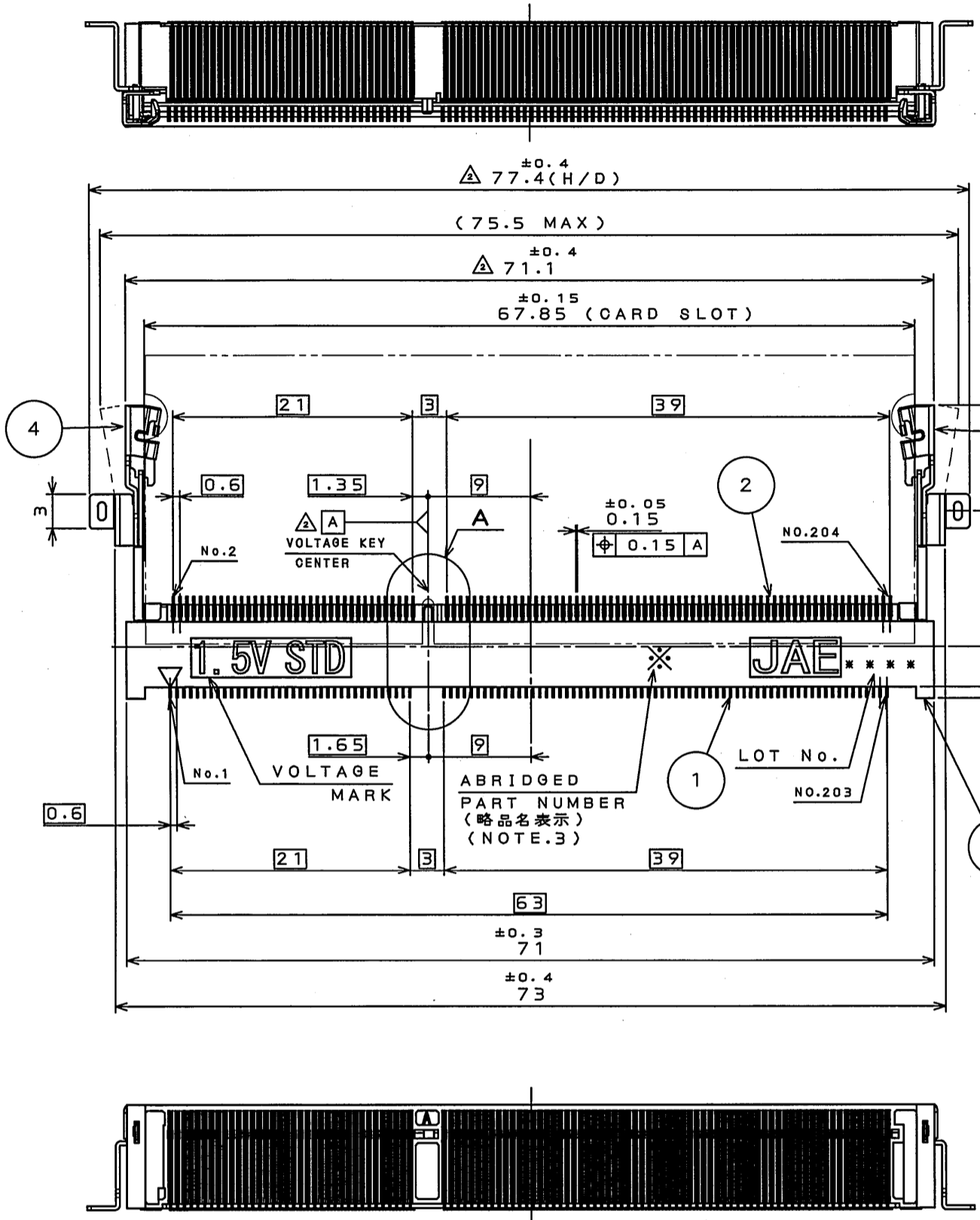
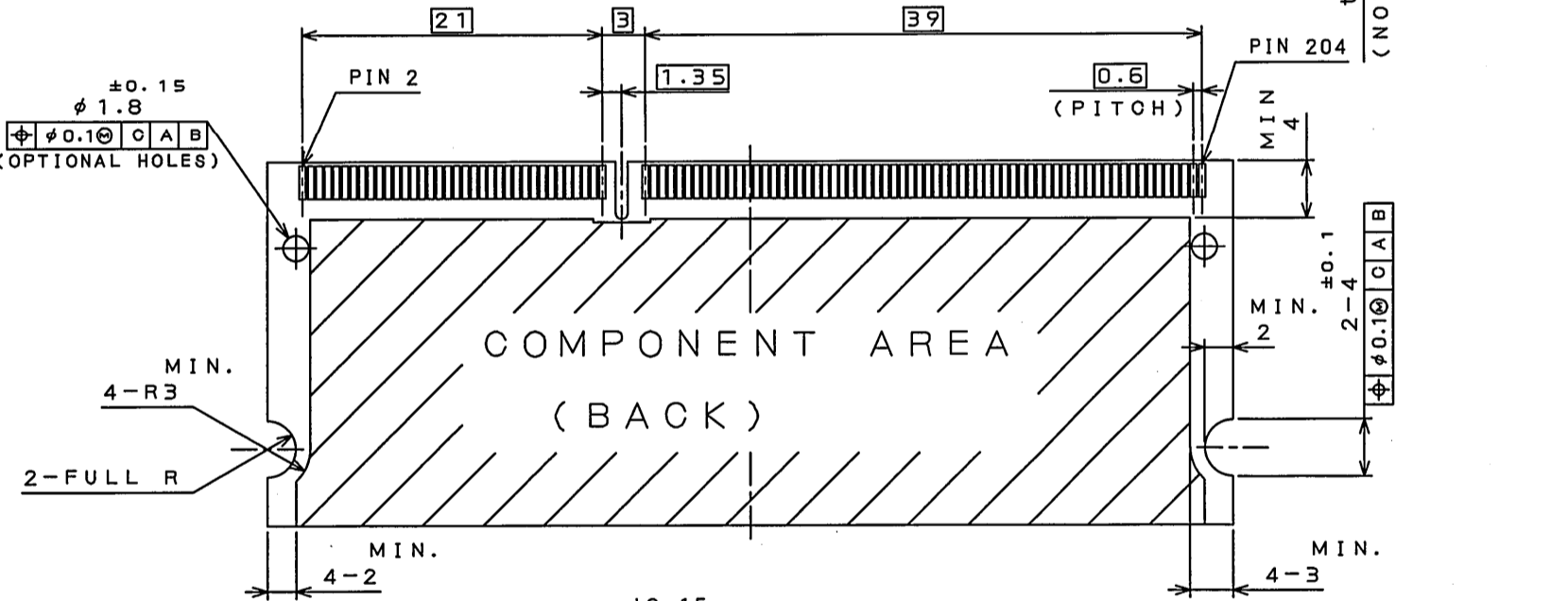
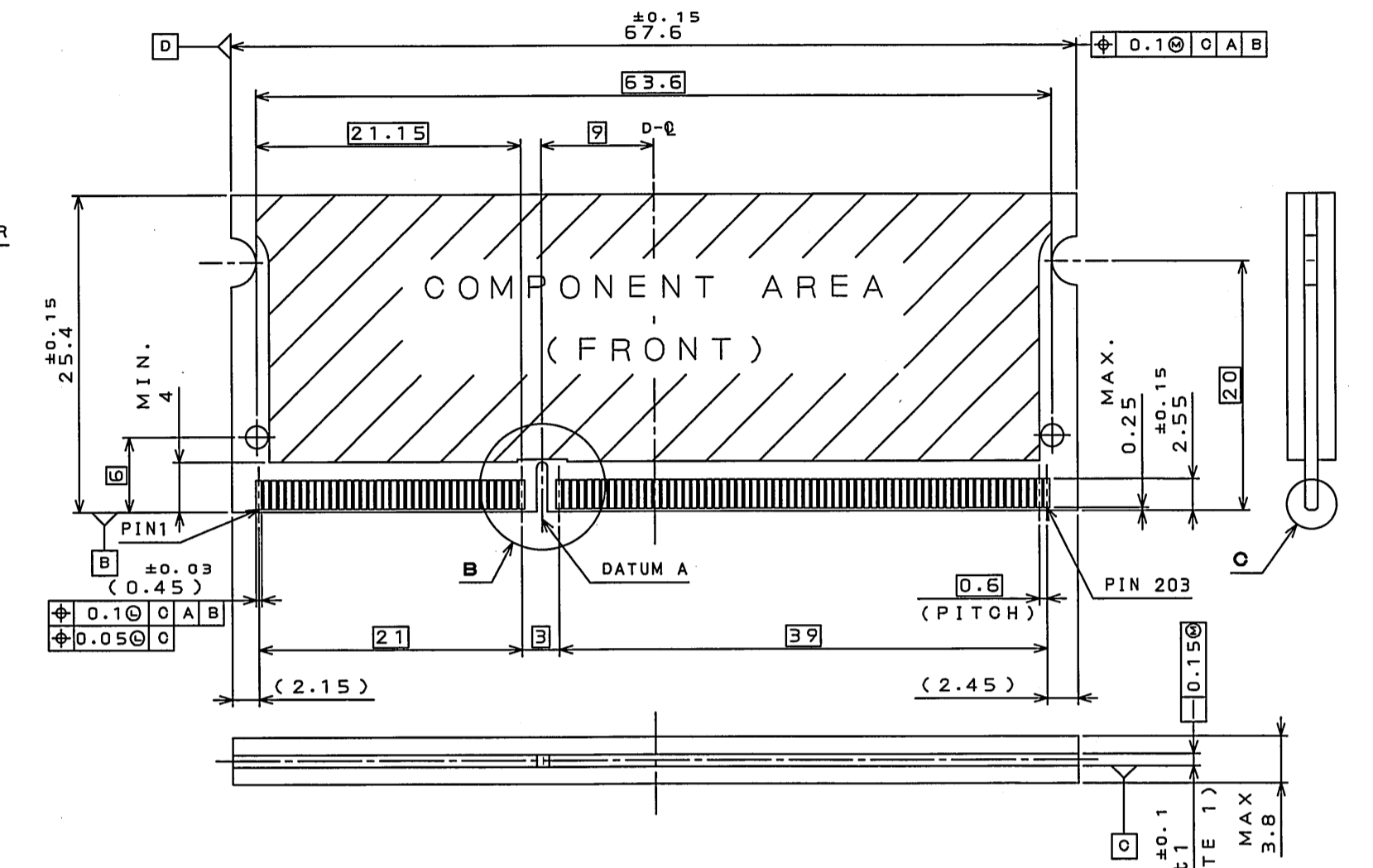


REV.	DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	10.Feb.2011	071605	LATCH SHAPE CHANGE AND GEOMETRY ALLOWANCE ADD		R.KATOU		T.Shindou

APPLICABLE DIMM(REF.)



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)



DESIGNATION

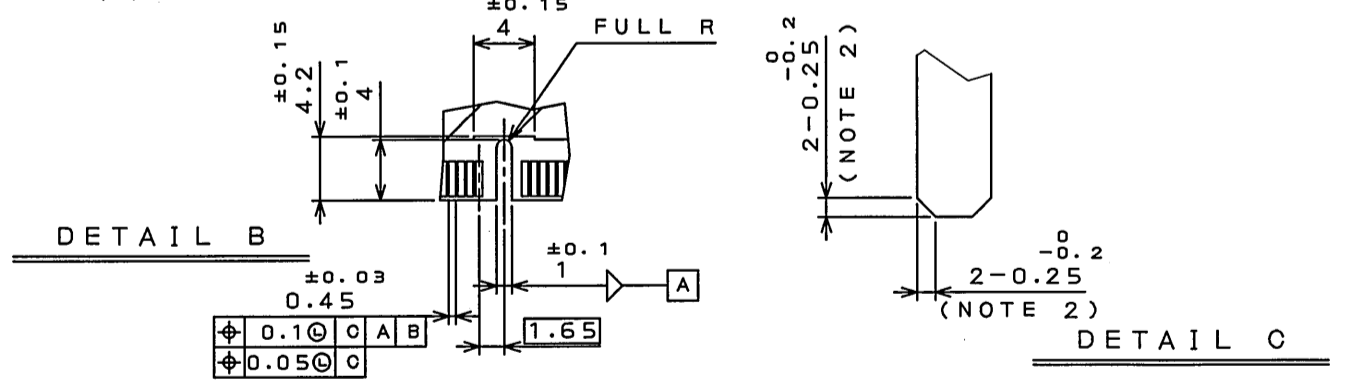
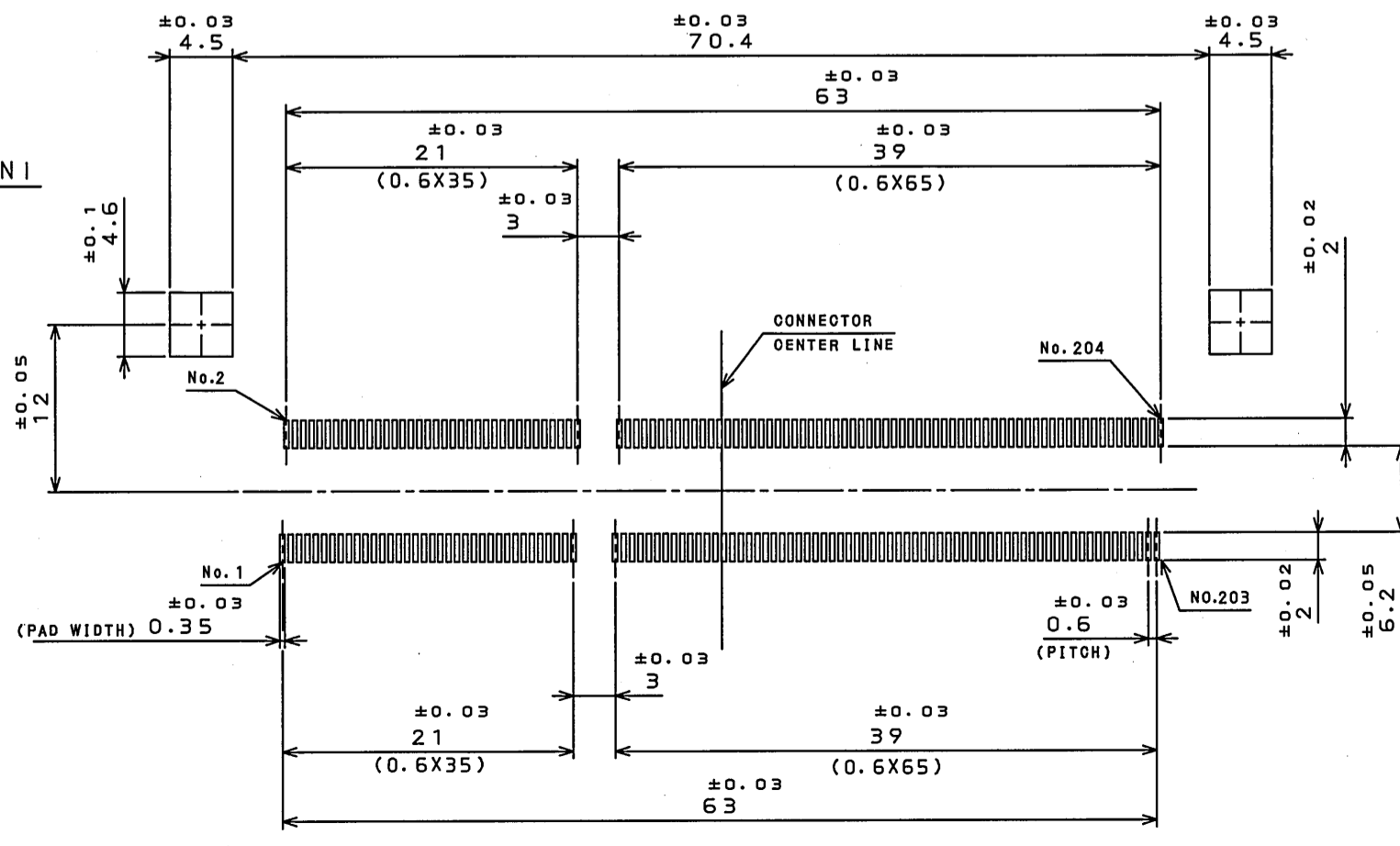
MM80-204B1-E1

SERIES シリーズ	CONTACT FINISH 接点仕上げ 1:Au(0.1μm MIN) OVER NI
NO. OF CONTACTS 芯数	MODIFY CODE モディファイコード E:9.2mm HEIGHT
SOCKET TYPE ソケットタイプ B:LATCH TYPE SMT	KEYING TYPE キタイプ 1:1.5V

NOTE 1. CARD THICKNESS INCLUDES PAD PLATING.
NOTE 2. BEVEL MUST BE FREE OF CUTTING BURRS.
NOTE 3. ABRIDGED PART NUMBER IS DISPLAYED AS BELOW

MM80-204B1-E1
ABRIDGED PART NUMBER

注1. カートの厚みは、接点部パッドのめっきを含んだ厚みを適用します。
注2. 先端面取り部は、バリなど無き事。
注3. 略品名表示は下記下線部分を表示します。
MM80-204B1-E1
略品名



NO.	DESCRIPTION	QTY.	MATERIAL	FINISH	REMARKS
5	LATCH 2	1	STAINLESS	TIN PLATING	
4	LATCH 1	1	STAINLESS	TIN PLATING	
3	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP		
2	LOWER CONTACT	102	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: Au(0.1μm MIN) OVER NICKEL SOLDERING AREA: GOLD FLASH OVER NICKEL	
1	UPPER CONTACT	102	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: Au(0.1μm MIN) OVER NICKEL SOLDERING AREA: GOLD FLASH OVER NICKEL	

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)	JACS-10662	第1版(ORIGINAL DATE)	24.AUG.2010	度(SCALE)	2:1
製造 DR.		製図 DR.		名称(TITLE)	MM80-204B1-E1
公差(GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	R.KATOU	製図 APPD.	T.SHINDOU
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	承認 APPD.		重量(MASS)	
. ±0.8	° ±				
.X ±0.4	°X ±				
.XX ±0.1					
.XXX ±					

D01-0-21EF(05.08)

SIZE A2